

江苏微导纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	Grand Alliance Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、Pleiad Investment Advisors Limited、WFM Asia (HK) Limited、Manulife Investment Management (Hong Kong)、Rays Capital Partners Limited、Frontier Capital Management Limited、Bank of America、安信基金、一久私募、方正证券、东方财富证券、博时基金、金鹰基金、国寿安保基金、中信证券、中信建投基金、中银基金、全天候基金、太平洋证券、鲸鸿私募、宁波乾弘久盛		
公司接待人员姓名	董事会秘书龙文、证券事务代表朱敏晓、证券部王少峰		
日期/时间	2025 年 11 月 7 日-2025 年 11 月 13 日	地点	公司会议室
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司简介 微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造制造商，向下游半导体、泛半导体客户提供尖端薄膜设备、配套产品及服务。 公司是国内首家成功将量产型 High-<i>k</i> 原子层沉积设备（ALD）应用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商，是国内首批成功开发并进入产业链核心厂商量产线的硬掩膜化学气相沉积设备（CVD）国产厂商，也是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一。产品已覆盖逻辑、存储、先进封装、化合物半导体等多个细分领域。		

	2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 17.22 亿元，同比增长 11.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,849.52 万元，同比增长 64.83%。其中，受益于国产存储芯片产能的持续扩充，以及逻辑、先进封装等领域设备国产化率的提升，公司半导体业务持续放量，订单和收入均实现了快速增长。2025 年 1-9 月，公司半导体设备营业收入 5.26 亿元，同比增长 78.27%，占营业收入的比例达到 30.56%；半导体领域新增订单约 14.83 亿元，同比增长 97.26%。 二、主要交流问题及回复 1、本轮存储芯片的"超级周期"对公司业务发展有何积极影响？ 公司将显著受益于国内存储芯片头部客户的加速扩产与工艺升级。 公司作为国内领先的 ALD 与高端 CVD 设备供应商，设备已广泛应用于国产存储芯片产线，半导体新增订单中超过 80%来自于存储芯片 NAND 与 DRAM 头部客户。为满足持续增长的市场需求，公司正积极扩大核心产品产能。 同时，公司还在持续推出新产品，相关工艺技术对推动存储芯片技术迭代尤其是 3D DRAM、3D NAND 技术的研发与产业化具有关键支撑作用。展望未来，随着存储芯片 3D 结构堆叠层数持续提升及客户产能规模加速扩张，相关设备需求有望持续放量。 2、公司 ALD 设备和高端 CVD 设备市场竞争力如何？ 公司是国内领先的 ALD 设备供应商，相关产品涵盖了行业所需主流 ALD 薄膜材料及工艺，在高介电常数材料、金属化合物薄膜等领域均实现了产业化应用，量产规模不断增加。高端 CVD 设备方面，公司实现了硬掩膜等关键工艺的技术和产业化突破，订单和产品规模持续增长。 3、ALD 技术在存储芯片技术演进中发挥怎样的关键作用？ 随着存储芯片转向 3D 架构，堆叠层数不断增加，器件结构
--	---

日趋复杂。在此背景下，传统沉积工艺已难以在复杂三维结构内实现均匀、保形的薄膜沉积。ALD（原子层沉积）技术凭借其优异的三维覆盖能力和原子级膜厚控制精度，成为制造 3D NAND 和 3D DRAM 不可或缺的核心工艺。在国产存储芯片向更高层数与技术节点迭代的过程中，ALD 技术的作用愈发关键，需求持续提升。

4、CVD 硬掩膜工艺在存储芯片制造中又有怎样的关键作用？

CVD 硬掩膜工艺是集成电路领域应用广泛的工艺之一，尤其是无定形碳沉积的硬掩膜，属于其中最为先进和有技术难度的部分之一。该工艺制备的无定形碳硬掩膜具有优异的刻蚀选择比，能够在长时间刻蚀过程中保持图形完整性，确保在数百层的堆叠结构中将设计图形精准转移到下层介质，为实现存储芯片的高密度集成提供了关键技术保障。

5、公司在存储芯片之外的其他半导体领域取得了哪些进展？

除存储芯片外，公司在逻辑芯片和先进封装领域均取得重要突破。逻辑芯片领域，公司与国内主流厂商保持着稳定合作，多款设备已通过客户严格的技术验证，关键指标达到国际先进水平，能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。随着国内市场对高端国产薄膜沉积设备需求的增长，该领域业务有望保持增长态势。

先进封装领域，公司相关设备已在客户端进行验证，并与多家潜在客户开展技术交流。公司作为国内少数具备该领域设备研发与生产能力的企业之一，具有先发优势，相关业务预计将获得良好的发展机遇。

6、公司在半导体设备国产化进程中做出了哪些贡献，未来有什么样的发展战略？

公司定位为国产高端薄膜沉积技术领域的创新引领者。我国

	半导体设备产业在部分细分领域已取得显著进步，但整体国产化率仍处于较低水平，尤其在薄膜沉积等核心设备领域，中高端产品的国产化进程明显滞后，相关产品的需求尤为紧迫。 公司凭借在高端薄膜沉积领域的技术积累，持续助力国内半导体产业的发展。过去几年，公司聚焦于国内半导体产业最亟需关键环节，在 ALD、高端 CVD 等设备上取得了一系列技术突破并实现产业化应用，产品技术获得了逻辑、存储、先进封装、化合物半导体等多个领域头部客户的认可，并持续获得高端薄膜沉积设备的订单。 未来，公司将继续聚焦半导体高端薄膜工艺和解决方案，持续推动半导体设备国产化进程，服务并引领半导体新架构、新器件发展。
风险提示	1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2、电话会议参会名单由会议组织方提供。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件	无